

# 2010年3月期(09年度) 第2四半期決算説明会

2009年11月11日  
株式会社 東京精密

# 将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料及び当社代表者が口頭にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従いまして、実際の今後の当社の業績が、本プレゼンテーションにおける記述、情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



# 第2四半期(累計)業績

単位:億円

	08年度		09年度		
	上期	下期	上期	08年下期比	前年同期比
<b>売上高</b>	<b>318</b>	<b>139</b>	<b>115</b>	△18%	△64%
半導体	<b>192</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	+26%	△64%
計測	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>45</b>	△46%	△64%
<b>営業利益</b>	<b>21</b>	<b>△46</b>	<b>△20</b>	-	-
半導体	△6	△53	△21	-	-
同率	-	-	-	-	-
計測	27	8	1	△86%	△95%
同率	21%	9%	3%	-	-
<b>経常利益</b>	<b>26</b>	<b>△54</b>	<b>△24</b>	-	-
<b>当期利益</b>	<b>△2</b>	<b>△110</b>	<b>△38</b>	-	-

# 第2四半期実績：3ヶ月推移

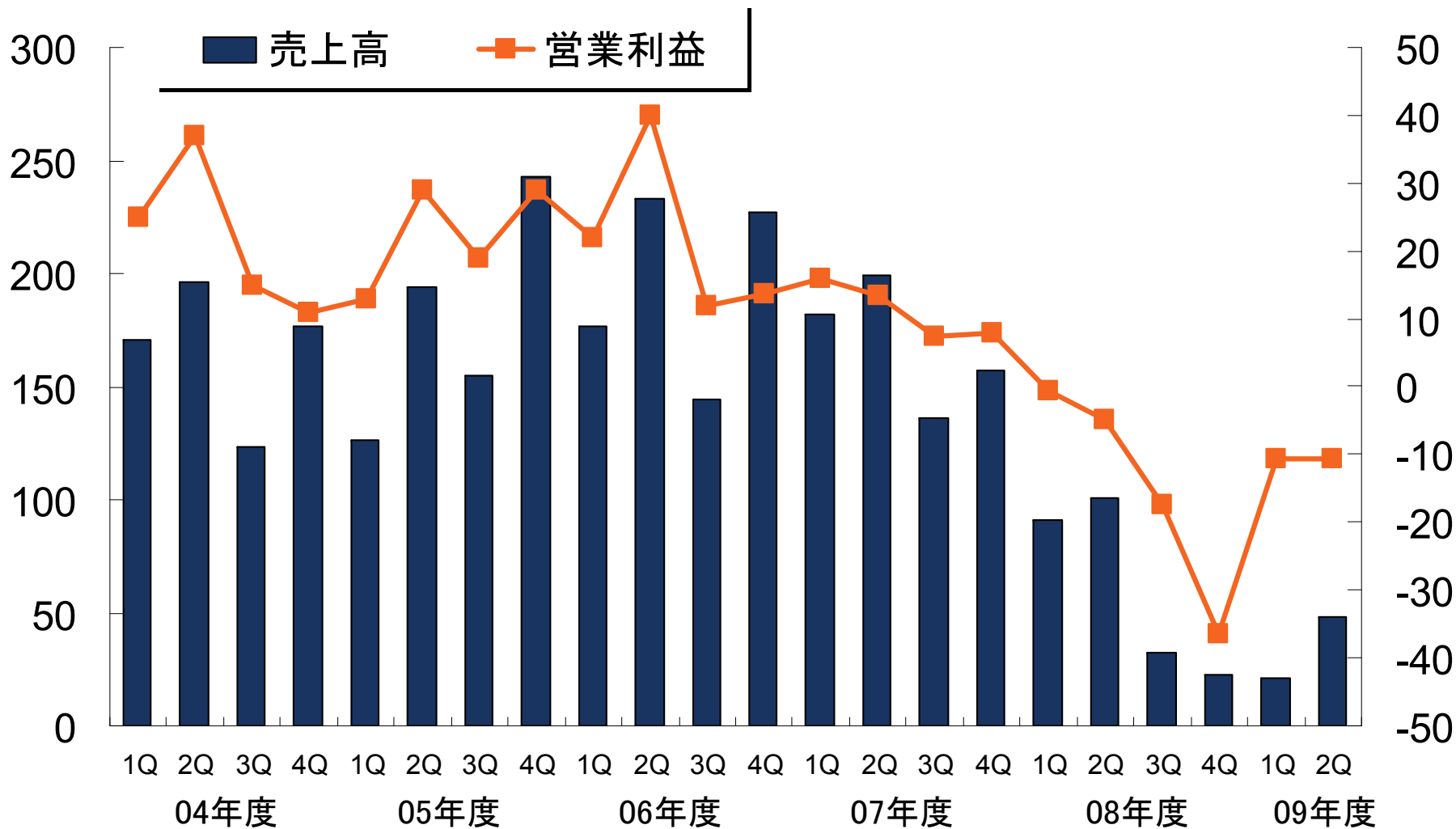
単位：億円

	08年度				09年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前期比
<b>売上高</b>	<b>149</b>	<b>169</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	+76%
半導体	91	101	32	23	21	48	+128%
計測	58	68	46	38	20	25	+21%
<b>営業利益</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>△11</b>	<b>△35</b>	<b>△12</b>	<b>△8</b>	-
半導体	△1	△5	△17	△36	△11	△10	-
同率	-	-	-	-	-	-	-
計測	13	14	6	1	△1	2	-
同率	22%	21%	14%	4%	-	10%	-
<b>経常利益</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>△20</b>	<b>△33</b>	<b>△12</b>	<b>△12</b>	-
<b>当期利益</b>	<b>△6</b>	<b>4</b>	<b>△87</b>	<b>△23</b>	<b>△17</b>	<b>△21</b>	-

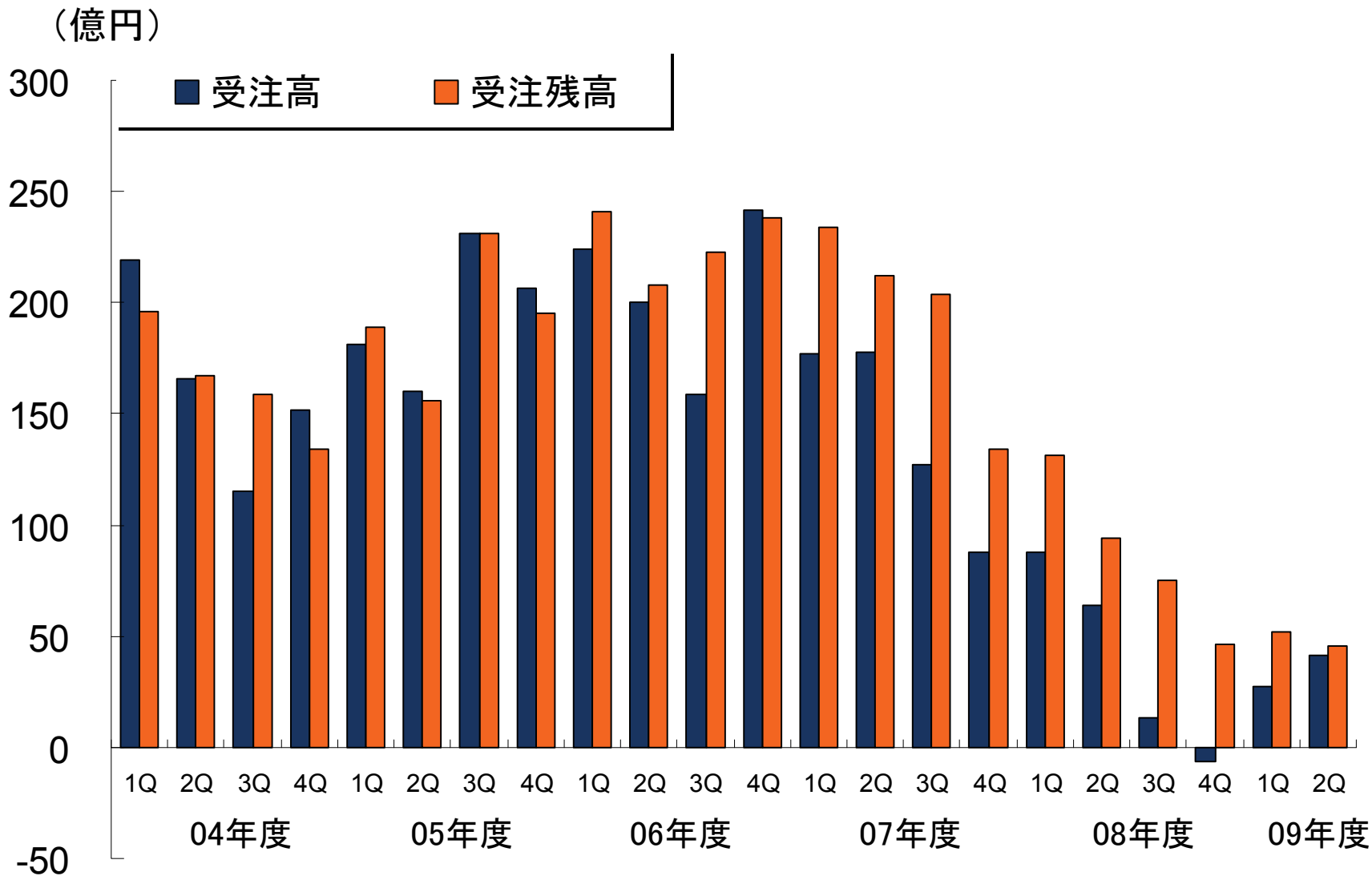
# 半導体事業の業績推移

売上高 (億円)

営業利益(億円)



# 半導体事業の受注推移



# 半導体事業の地域別売上高推移

売上高海外比率

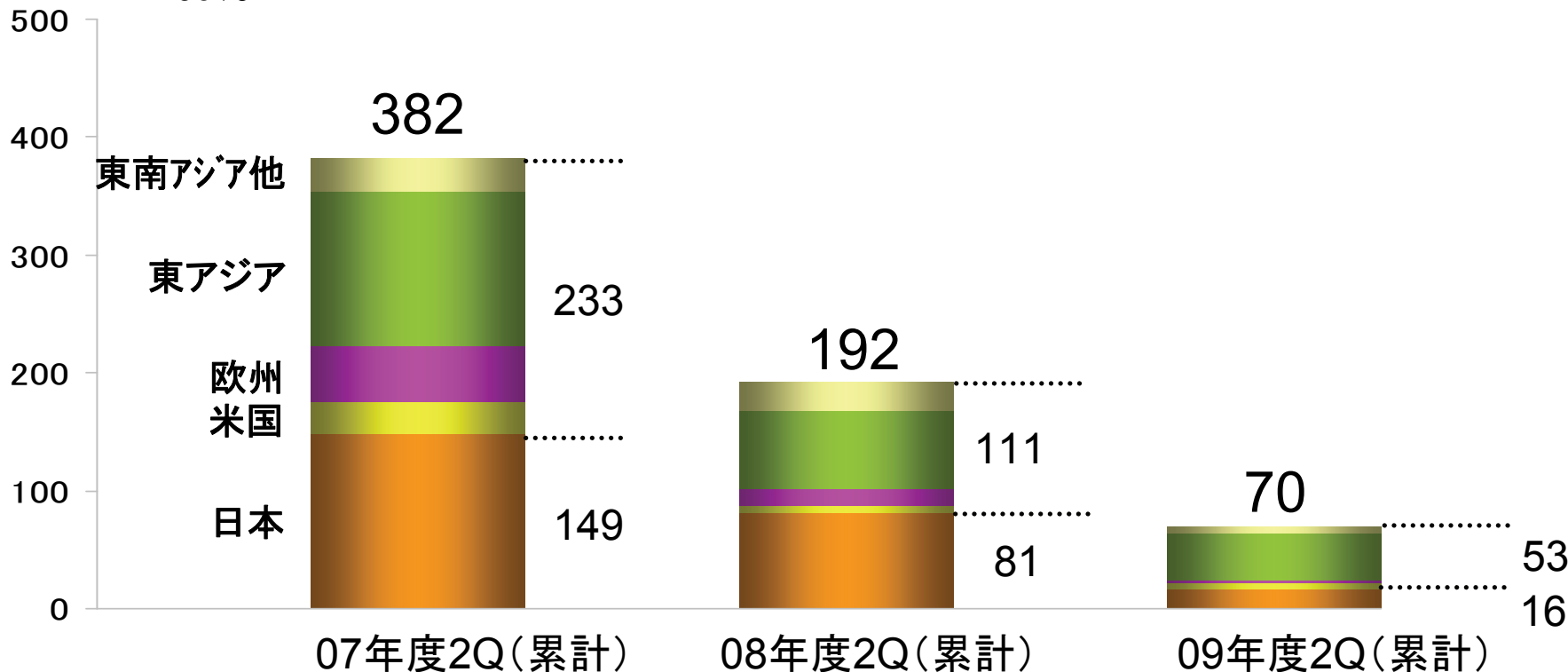
90%  
80%  
70%  
60%  
50%

61%

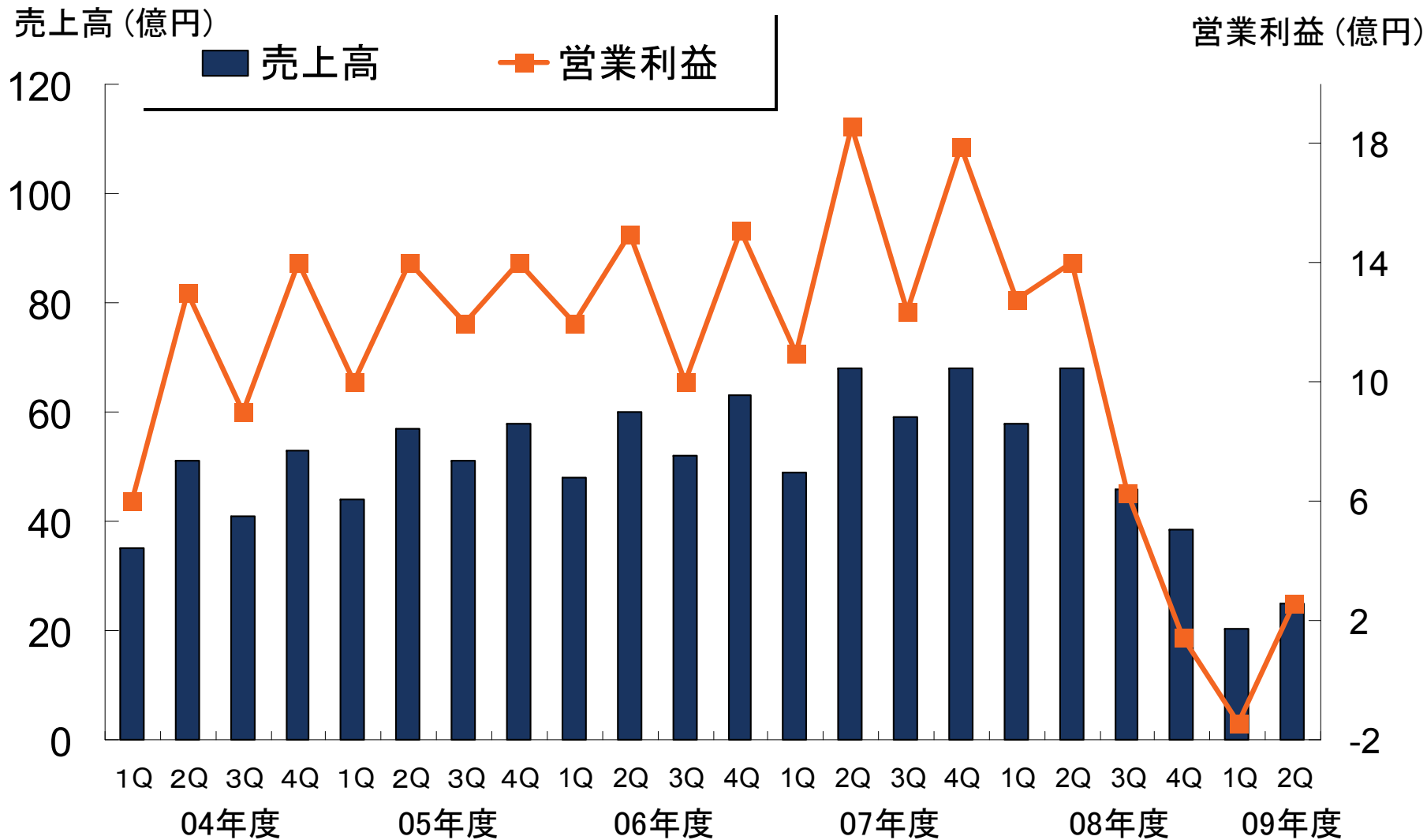
58%

77%

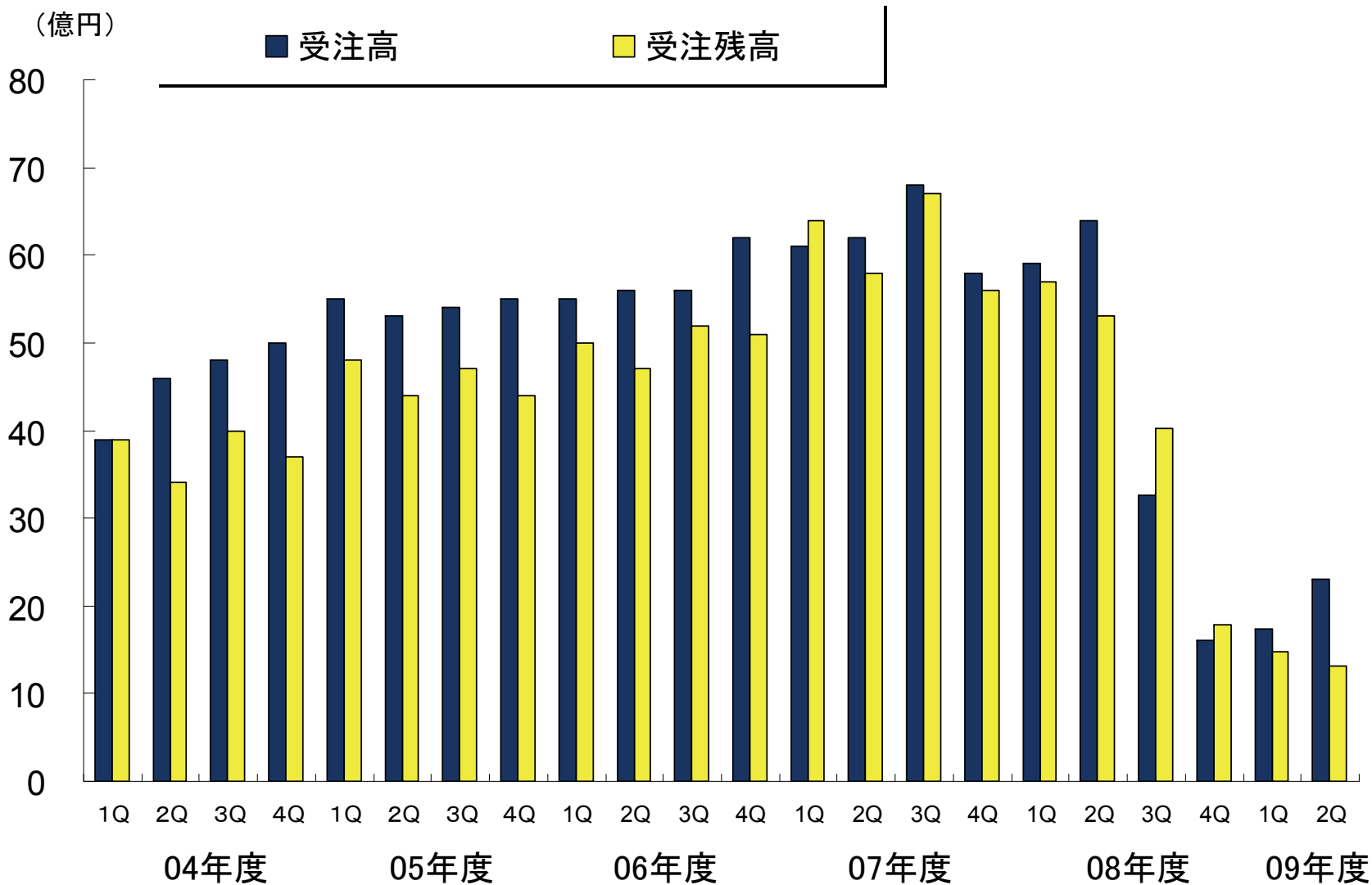
(億円)



# 計測事業の業績推移

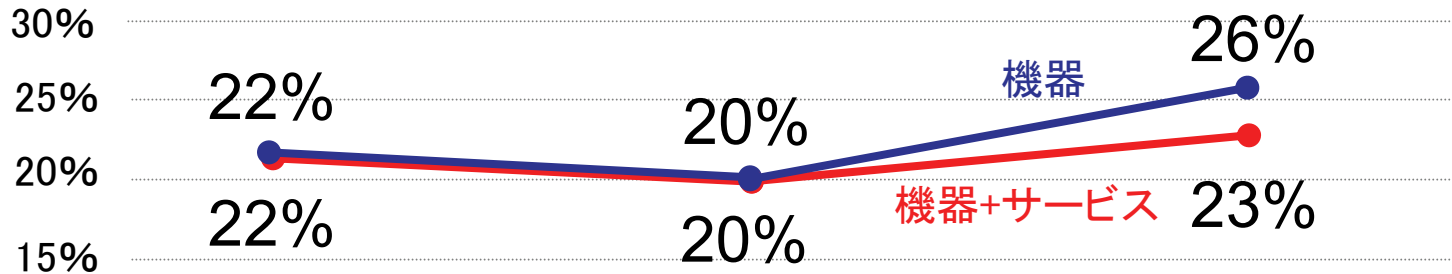


# 計測事業の受注推移

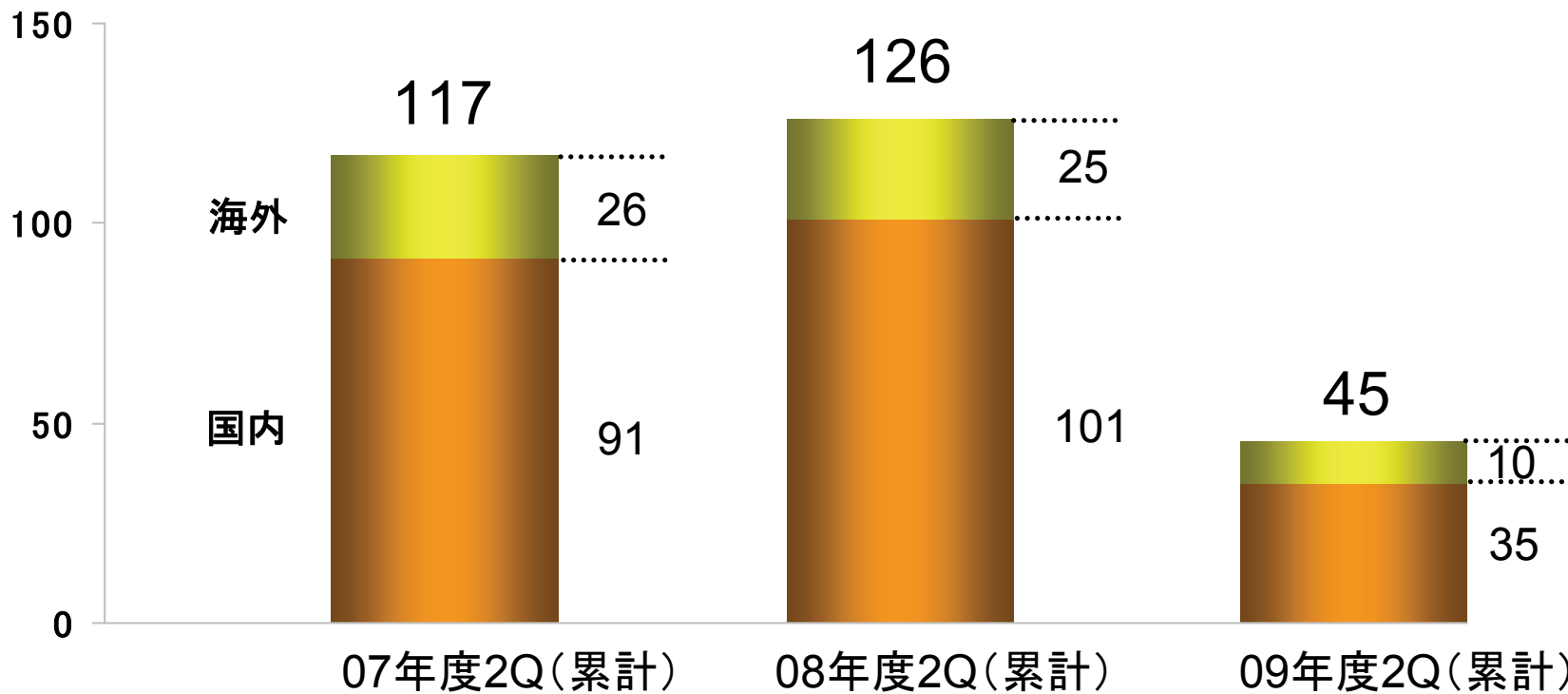


# 計測事業の地域別売上高

売上高海外比率



(億円)



# 貸借対照表

(単位:億円)

資産	09/3末	09/9末	増減	負債/純資産	09/3末	09/9末	増減
現預金	176	108	△68	支手・買掛金	53	30	△23
受取手形・ 売掛金	119	99	△20	借入金・社債	146	97	△49
在庫	180	146	△34	その他	50	26	△24
その他	28	13	△15	流動負債計	249	<b>153</b>	△96
流動資産計	503	<b>366</b>	△137	固定負債計	161	<b>137</b>	△24
固定資産計	315	<b>299</b>	△16	負債計	410	<b>290</b>	△120
資産合計	818	<b>665</b>	△153	純資産	408	<b>375</b>	△34
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	818 (261)	<b>665</b> <b>(201)</b>	△153 (△60)

# キャッシュフロー

(単位:億円)		07年度1~2Q	08年度1~2Q	09年度1~2Q
現金等 期首残高		168	157	176
営業活動	税引前・利払前・償却前利益	72	13	△ 10
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	19	30	31
	納税	△ 35	△ 20	△ 1
	退職給付引当金	0	1	△ 12
	その他	△ 11	△ 1	△ 13
小計		45	23	△ 6
投資活動		△ 36	△ 13	△ 1
フリーキャッシュフロー		9	10	△ 7
財務活動	社債・借入	△ 18	17	△ 62
	配当金等	△ 10	△ 16	△ 0
	小計	△ 28	1	△ 62
増減額		△ 18	10	△ 68
現金等 期末残高		151	166	108

# 従業員数推移

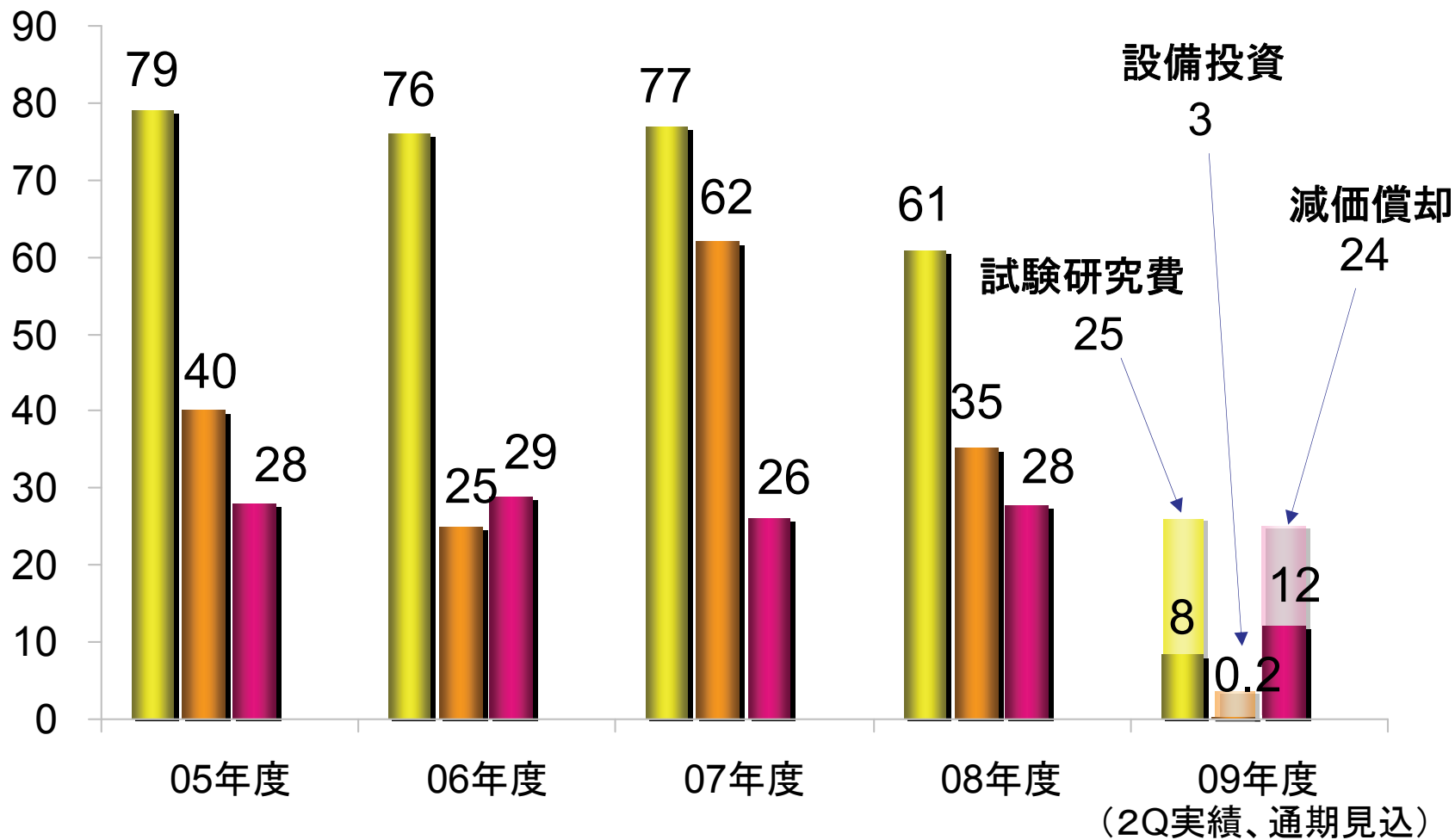
(人)

	08/3末	08/9末	09/3末	09/9末
<b>合計</b> (連結/ 正社員+臨時従業員)	2,198	2,020	1,495	<b>1,153</b>

- ◆ 下期に入り、生産回復に伴い、臨時従業員70名を採用

# 試験研究費、設備投資、減価償却

(億円)



## ◆半導体

- 半導体メーカーの設備稼働率回復
- 設備増強への対応は、慎重／積極 斑模様

## ◆計測

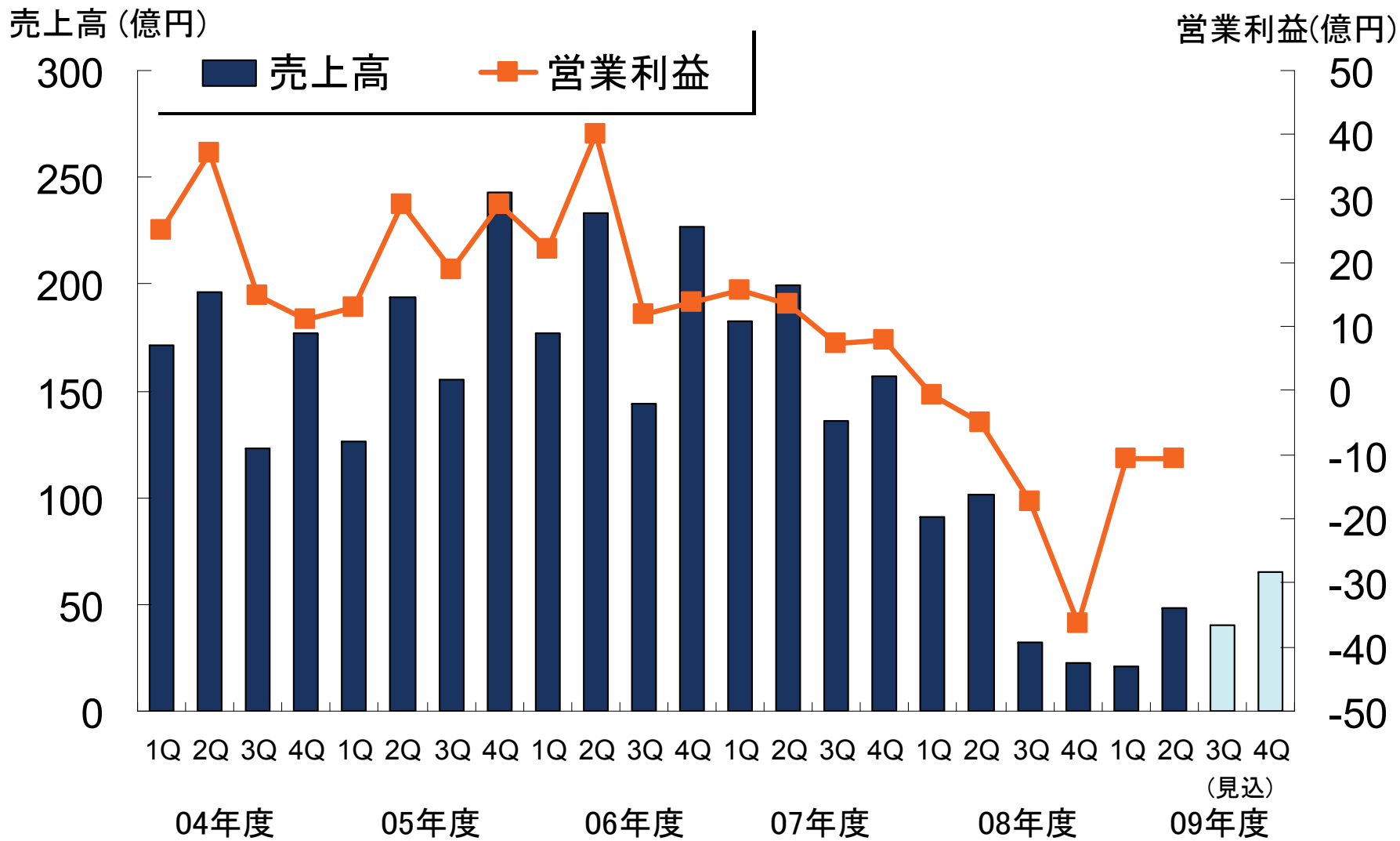
- 自動車関連産業の設備投資抑制継続中
- 2009年度を底と見るが、国内回復には時間を要す
- 海外市場(中国、インド、東南アジア)が活発化

# 09年度 通期業績予想

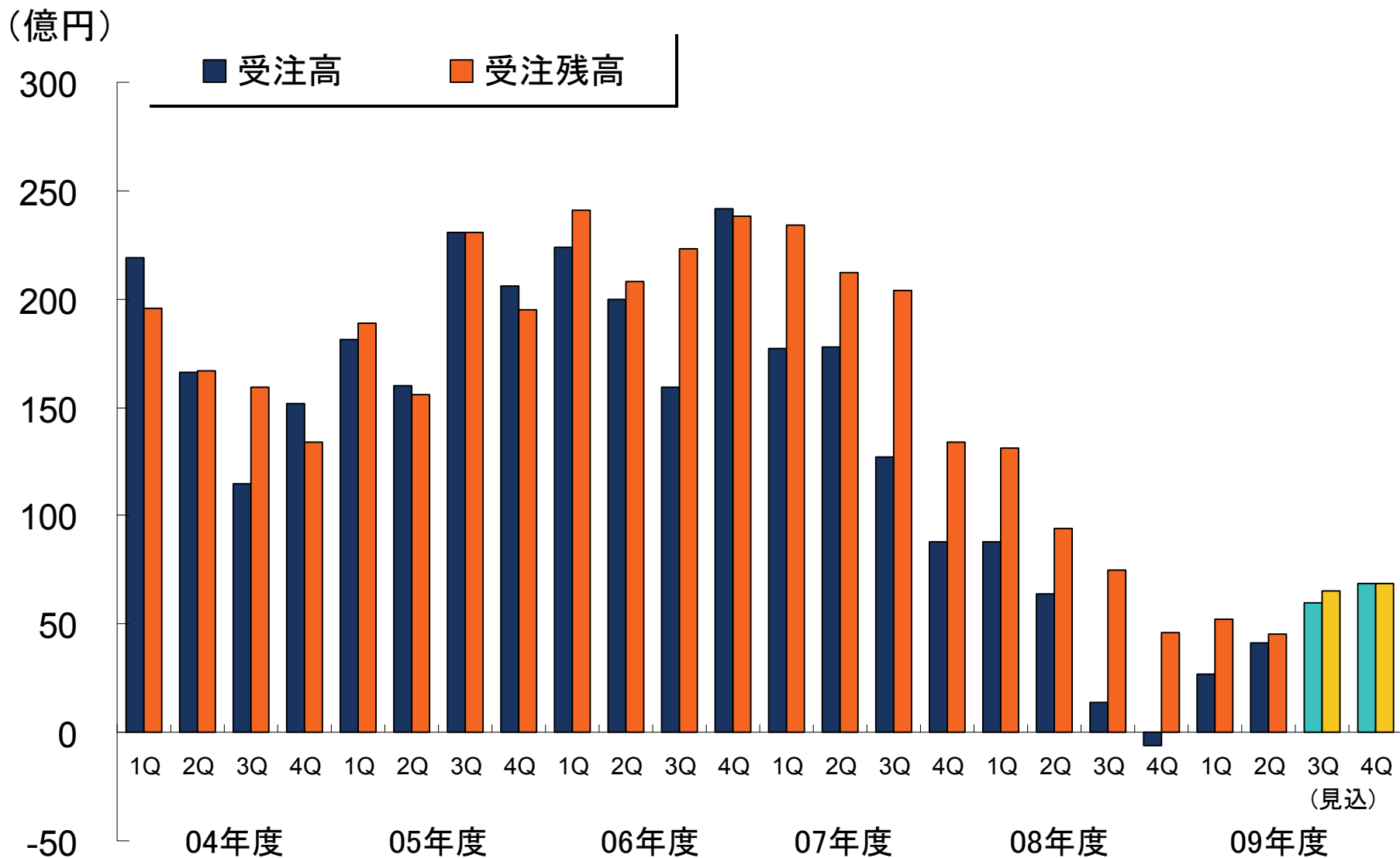
単位: 億円

	08年度			09年度			
	上期	下期	通期	上期	下期予想	通期予想	前年比(%)
<b>売上高</b>	<b>318</b>	<b>139</b>	<b>457</b>	<b>115</b>	<b>155</b>	<b>270</b>	△ 41%
半導体	<b>192</b>	<b>55</b>	<b>247</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>	△ 29%
計測	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>210</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	△ 55%
<b>営業利益</b>	<b>21</b>	△ <b>46</b>	△ <b>25</b>	△ <b>20</b>	△ <b>3</b>	△ <b>23</b>	-
<b>経常利益</b>	<b>26</b>	△ <b>54</b>	△ <b>28</b>	△ <b>24</b>	△ <b>3</b>	△ <b>27</b>	-
<b>当期利益</b>	△ <b>2</b>	△ <b>110</b>	△ <b>112</b>	△ <b>38</b>	△ <b>5</b>	△ <b>43</b>	-
<b>配当</b>	<b>15円</b>	<b>0円</b>	<b>15円</b>	<b>0円</b>	<b>未定</b>	<b>未定</b>	-

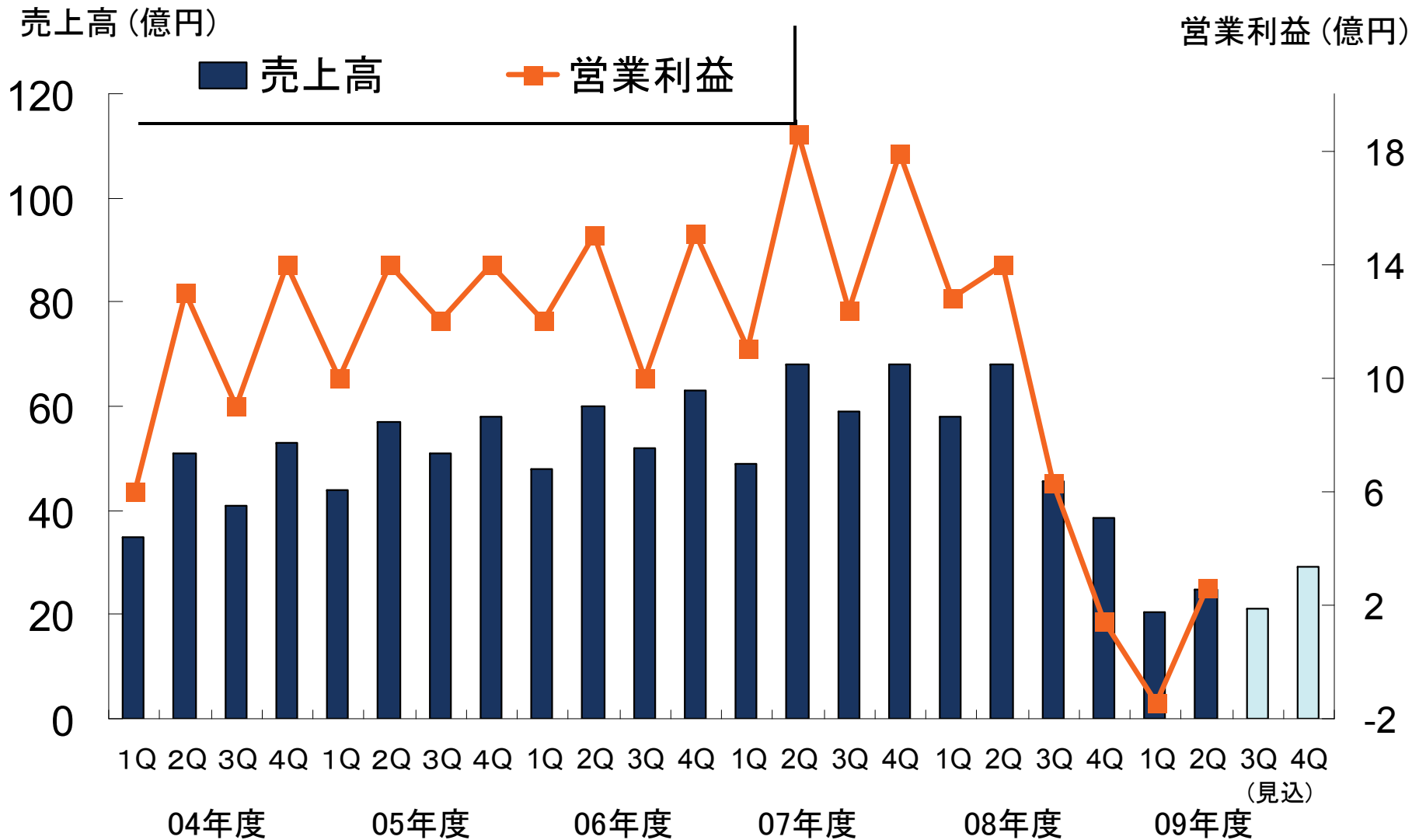
# 半導体事業の業績推移(見込)



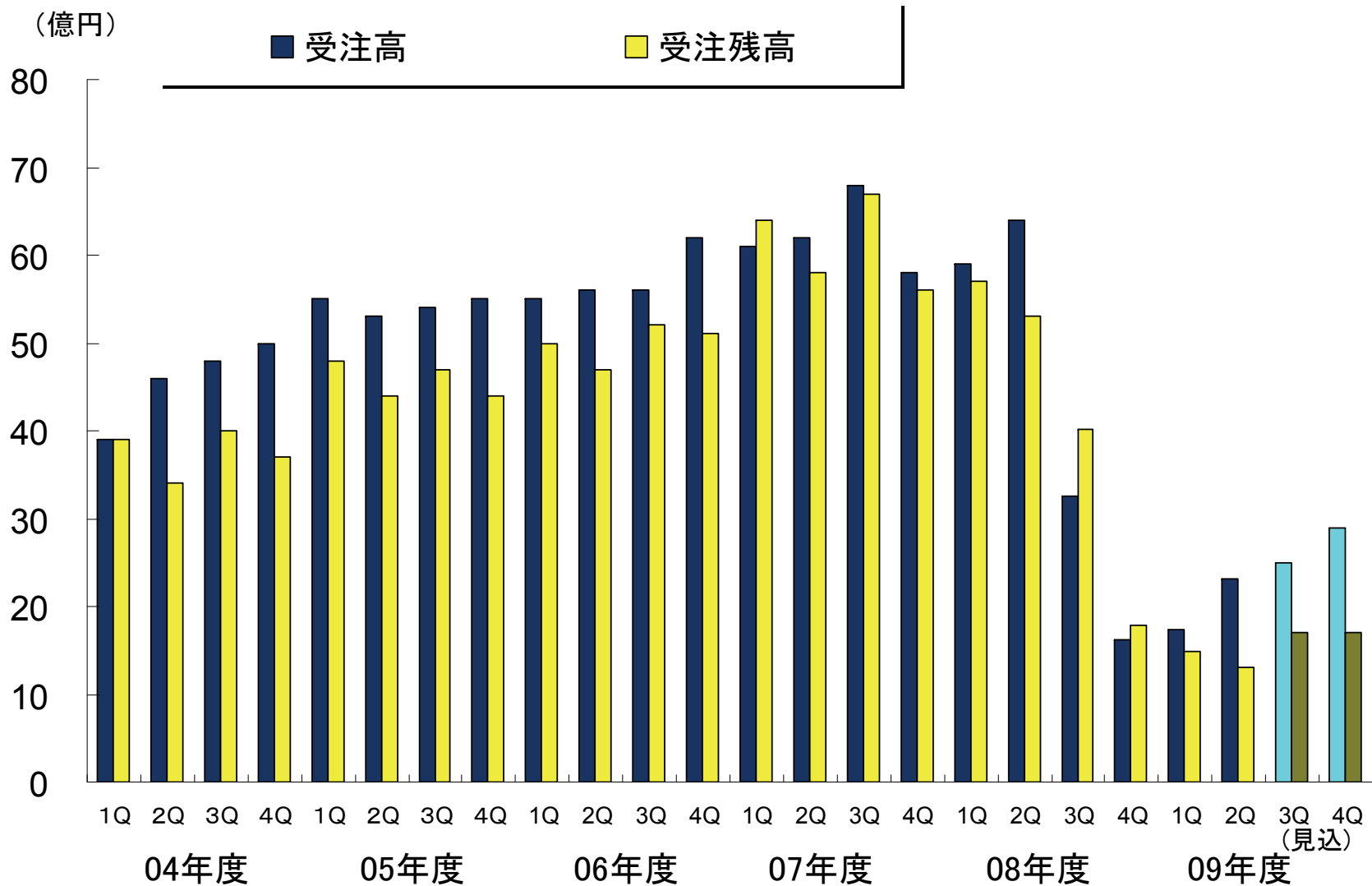
# 半導体事業の受注推移(見込)



# 計測事業の業績推移(見込)



# 計測事業の受注推移(見込)



# 回復期に向けて

## ◆利益体質の強化

- 回復期に向けた体制構築、効率化への取り組み

## ◆成長分野を捉えた製品戦略

- 顧客ニーズを踏まえた製品ラインアップの拡充

# 回復期に向けた体制構築①

## ◆生産体制

- 臨時従業員雇用再開など生産増対応を開始
- 製品混流による柔軟な生産体制確立済み

## ◆本社機能の移転

- 三鷹 ⇒ 八王子
- 管理業務の一層の効率化

# 回復期に向けた体制構築②

## ◆在庫回転率の向上

(億円、回)

	07/3末	08/3末	09/3末	09/9末	10/3末見込
棚卸資産	272	277	180	146	139
在庫回転率	4.3	3.3	1.4	2.0	3.1

\*回転率は各直前3ヶ月売上を基に算出

## ◆CR強化

- 製品横断的にユニット(部品)を共通化
- 技術/製造の連携強化



東京精密は  
アクレーテクです